

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

杨凌美畅新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	通过网络方式参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的投资者
时间	2026年5月20日下午15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
公司接待人员姓名	董事长、总经理：柳海鹰 董事会秘书、财务总监：周湘
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司目前主营业务今年的增长空间有多少，产能相对去年提高多少</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营正常，将根据下游市场需求及订单情况动态调整生产。关于2026年度的业务增长及产能情况，请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！</p> <p>2、请问董事长，原始技术股东贾海波一直在减持股份，除了其个人资金原因外，是因为公司技术研发到瓶颈了，没有大的发展潜力了么</p>

答：尊敬的投资者，您好！股东减持系其个人资金安排，与公司经营及技术研发无关。公司始终坚持以技术创新为核心，推进技术迭代和产品升级，以实际经营业绩回馈投资者。感谢您的关注！

3、董事长您好，感谢柳总的回复。当前光伏电池技术正加速向 BC、HJT 及 OBB（无主栅）方向迭代，这类高效电池对硅片切割的线痕控制、TTV（总厚度偏差）和隐裂率提出了远高于 PERC 时代的要求，同时硅片减薄趋势明显。请问公司是否已针对 BC 电池专用硅片开发出高良率、低损伤的差异化金刚线切割方案？在 OBB 技术配套方面，公司是否有 28 μm 以下超细钨丝金刚线的量产储备，以满足更薄硅片的切割需求？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续关注着行业前沿技术发展，始终秉持“生产一代、储备一代、研究一代”的发展方针。围绕客户的差异化需求，公司已形成成熟的产品矩阵并实现稳定量产。同时，公司具备 28 μm 以下钨丝金刚线的稳定量产能力，持续引领金刚线细线化迭代。感谢您的关注！

4、公司废钨回收业务目前是否饱和，后续还有多大增长空间？

答：尊敬的投资者，您好。公司的钨丝回收业务主要是基于公司的产品——钨丝金刚线，经由客户用于切割硅片后，产生的废旧钨丝金刚线进行的回收、金属再生处理。故而其将随公司钨丝金刚线产品的销售而持续。感谢您的关注。

5、钨丝回收业务现在的市场需求，公司后续是否还有增长空间？

答：尊敬的投资者，您好。公司的钨丝回收业务主要是基于公司的产品——钨丝金刚线，经由客户用于切割硅片后，产生的废旧钨丝金刚线进行的回收、金属再生处理。故而其将随公司钨丝金刚线产品的销售而持续。感谢您的关注。

6、董事长您好，自 2023 年初至今，公司股价持续低于发

行价，投资者信心受到一定影响。请问公司如何看待当前股价与内在价值的偏离？在提振市场信心、修复估值方面，公司有哪些具体举措？例如，是否有股份回购、高管增持或引入战略投资者等计划？

答：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受宏观经济、行业状况、市场流动性等多种因素影响。公司始终重视投资者回报，上市以来持续通过现金分红、股份回购等方式回馈股东。公司将继续坚守主业，深化提质增效与技术创新，以扎实的经营基本面支撑价值成长。后续如有股份回购、高管增持等相关计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

7、请问公司的产品是否可以用于电子产品的切割，这一块的市场有多大，发展潜力如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品金刚石线主要用于光伏硅片等硬脆材料的切割。谢谢！

8、董事长您好，近期碳化硅（SiC）市场需求快速增长，市场关注度较高。请问公司在碳化硅晶圆切割用金刚石线方面是否有技术储备或产品布局？相比传统硅片切割，碳化硅切割对金刚石线在线径精度、抗拉强度、金刚石微粉把持力及切割良率等方面有哪些差异化要求？目前公司金刚石线产品是否已向天科合达、山东天岳等碳化硅衬底头部厂商送样验证或实现小批量供货？在第三代半导体领域的客户开拓方面，整体进展如何，是否已纳入公司第二增

答：尊敬的投资者，您好！公司产品金刚石线可用于碳化硅等半导体材料的切割，已针对半导体材料切割需求研发出专用系列产品，并已于多年前推向市场。目前该产品工艺成熟、质量可靠，能够满足客户的精密加工需求。需说明的是，相关业务在公司整体营收中占比较小，具体客户合作情况请关注公司后续披露的公告。谢谢！

9、董事长您好，近期碳化硅（SiC）市场需求快速增长，

	<p>市场关注度较高。请问公司在碳化硅晶圆切割用金刚石线方面是否有技术储备或产品布局？相比传统硅片切割，碳化硅切割对金刚石线在线径精度、抗拉强度、金刚石微粉把持力及切割良率等方面有哪些差异化要求？目前公司金刚石线产品是否已向天科合达、山东天岳等碳化硅衬底头部厂商送样验证或实现小批量供货？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司产品金刚石线可用于碳化硅等半导体材料的切割，已针对半导体材料切割需求研发出专用系列产品，并已于多年前推向市场。目前该产品工艺成熟、质量可靠，能够满足客户的精密加工需求。需说明的是，该业务在公司整体营收中占比较小，具体客户合作情况请关注公司后续披露的公告。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月20日